**2021年度関西地方学術講演会講演申込書**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講演の区分  （ ○印 ） | A．設計支援技術（設計の方法論，モデリング，解析，ヒューマンインターフェイス，設計支援システム）　　B．生産システム（モデリングと設計支援，運用計画と制御，システム・アーキテクチャ，ソフトウェアシステム，ネットワーキング，ライフサイクル設計）　　　　　C．材料と表面（機能材料/材料物性，表面，薄膜，ナノ構造）　　D．切削加工（加工機械・工具，加工法，センシング・モニタリング・制御技術）　　E．研削加工（加工機械・工具，加工法，センシング・モニタリング・制御技術）　　F．研磨加工（ラッピング・ポリシング，複合研磨，曲面研磨）　　G．物理化学加工（電気加工，化学的加工，高エネルギー密度加工，射出成形，マイクロリソグラフィ，その他の加工）　　H．機構（機構・解析，制御，機構要素，マイクロメカニズム）　　I．自動化技術（メカトロ機器，ロボット機構，ロボット制御，制御）　　J．計測・評価（（画像応用計測，光応用計測，形状測定，表面粗さ・性状評価，センシング技術，精度評価・データ処理）　　K．計算物理・シミュレーション（量子力学に基づくシミュレーション，古典力学に基づくシミュレーション）　　L．バイオ・メディカルエンジニアリング（ヒューマンサポート工学，医用工学，バイオサポート工学）　　M．新分野・その他 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 講 演 題 目 |  | | | | |
| 講 演 者  勤務先・  氏　名  （登壇者  に○印） |  | | | | |
| 連　絡　先（詳しくお書きください） | | | | | |
| 氏　　名 | |  |  | 電　　話 |  |
|  |
| 所属（部署） | |  |  | Ｆ Ａ Ｘ |  |
|  |
| 住　　所 | | 〒 |  | E-mail |  |